

●奥野製薬工業

ガラスコア基板用
めっき添加剤開発

奥野製薬工業(株)(大阪市
中央区)は、ガラスコア基
板スルーホールフィリング
用の硫酸銅めっき添加剤

「トップルチナGCS」シリーズを新たに開発した。板厚1・0mmまで生産レベルで対応できており、国内と海外それぞれ1社で採用が決定している。

同社は、プリント配線板のめっき薬品やパワー半導体用アンダーバリアメタル形成無電解めっきプロセスなどを手がけ、近年は先端パッケージ分野の新規プロセス開拓に注力している。

最先端の半導体パッケージは、サイズが年々大型化し、樹脂ベース基板では反りやうねりによって信頼性が低下してしまう。このため、樹脂に代わる材料として、平坦性に優れ、熱膨張率がシリコンに近いガラスが注目を集めているが、剛性を活かしながら微細化を図るとスルーホールのアスペクト比が高くなるという課題がある。

新製品は、スルーホールをコンフォーマルめっきではなく、めっきで充填(スルーホールフィリング)するための添加剤。PRパルスと直流電解用の硫酸銅めっき添加剤を併用することで、ボイドフリーかつ高速でスルーホールフィリングを実現できる。最大板厚Ⅱt1・0mm(ϕ 90 μ m)、最小ホール径60 μ m(t0・6mm)、アスペクト比10に対応可能で、ユーザーからもボイドが生じにくいとの評価を受けている。

